

[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1008552 B
EP 0815292 B1

[12]

STANDARD PATENT SPECIFICATION 標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
98108815.9

[51] Int.Cl.⁷ C25D

[22] Date of filing 提交日期
30.06.1998

[54] PROCESS FOR THE SELECTIVE OR PARTIAL ELECTROLYTIC METALLIZATION OF SURFACES OF SUBSTRATES MADE FROM NON-CONDUCTING MATERIALS 對非導電材料制造的基體表面進行選擇性或部分電解塗敷金屬的方法

[30] Priority 優先權

17.03.1995 DE 195 10 855.8

[43] Date of publication of application 申請發表日期

14.05.1999

[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期

14.07.2000

EP Application No. & Date 歐洲專利申請編號及日期

EP 96907505.0 15.03.1996

EP Publication No. & Date 歐洲專利申請發表編號及日期

EP 0815292 07.01.1998

Publication date of EP grant of the patent 批予歐洲專利的
發表日期 26.01.2000

[73] Proprietor 專利所有人

ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH, Erasmusstrasse 20-24,
D-10553 Berlin, Germany 阿托技術德國有限公司，德國

[72] Inventor 發明人

MIDDEKE, HERMANN

MC CASKIE, JOHN

JOSHI, NAYAN H.

[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址

China Patent Agent (H.K.) Ltd., 22/FI., Great Eagle Centre, 23,
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

中國專利代理(香港)有限公司，香港灣仔港灣道 23 號鷹君
中心 22 樓
